

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

2026年度向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年八月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 105,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目	51,290.91	43,000.00
高端半导体设备精密零部件生产制造项目	13,792.68	11,500.00
强瑞技术龙华区总部基地建设项目	30,649.33	22,000.00
补充流动资金	28,500.00	28,500.00
合计	124,232.92	105,000.00

注：项目实际名称以最终备案名称为准。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的实施背景和目的

（一）本次募集资金投资项目实施的背景

1、全球算力及半导体产业迎来发展红利，高端精密制造迎来战略发展机遇

算力基础设施是数字经济的核心底座，半导体产业是保障产业链自主可控的战略性基础产业，二者均为培育新质生产力、推动产业数字化转型的关键支撑。算力领域，当前以北美地区为代表的海外市场作为全球 AI 产业的主要阵地，当地政府持续出台人工智能顶层规划，头部科技巨头持续增加资本开支，加速布局通用大模型研发、大规模超算算力集群建设，持续带动液冷核心部件需求释放；半导体领域，近年来国家多部门密集出台产业扶持政策，大力推进关键设备及其核心零部件国产化替代，为半导体设备精密零部件等高端精密制造领域营造了良好的政策环境。国家高端半导体设备精密零部件属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类产业范畴，契合产业自主可控的战略导向。

公司深耕精密制造领域十余年，依托较强的定制化研发设计、高精度复杂零部件加工、全流程质量管控等核心能力，AI 服务器液冷散热相关产品已实现向头部客户稳定交付，半导体设备精密零部件产品也已实现向龙头厂商批量供货，业务布局与国家战略导向、行业发展趋势高度契合。本次发行是公司抢抓两大赛道战略机遇、加大产能与技术投入、巩固市场竞争优势的重要举措。

2、AI产业驱动需求共振，市场空间持续扩容

AI 大模型训练与推理需求爆发式增长，持续推高服务器单机柜功率密度，传统风冷散热逐步触及物理性能瓶颈。液冷凭借高效换热、低 PUE、高部署密度等核心优势，正由试点应用加速向规模化普及，成为高密度 AI 算力集群的标配散热方案。根据 Precedence Research 数据，2025 年全球 AI 服务器市场规模已达 392 亿美元，预计 2034 年将增长至 3,523 亿美元；下游算力硬件刚性升级与液冷方案加速渗透，共同拉动 AI 服务器液冷核心散热部件、自动化组装设备及检测设备需求快速扩容，市场成长确定性强。

AI 产业的高速发展同步带动上游半导体设备及配套零部件需求持续攀升。根据 SEMI 数据，2025 年中国半导体设备市场规模达 540 亿美元，2020-2025 年年均复合增长率 23.63%，预计 2027 年将增至 662 亿美元；弗若斯特沙利文预计，中国半导体设备零部件市场规模将从 2025 年的 1,929.9 亿元增长至 2029 年的 2,735.3 亿元，年均复合增长率约 9.1%。

AI 服务器液冷散热相关产品与半导体设备精密零部件两大细分赛道均深度受益于 AI 产业浪潮，下游需求共振向上，为公司业务拓展与产能扩张提供了充足的市场空间。

3、行业技术壁垒持续提升，核心工艺能力构筑竞争优势

AI 服务器液冷散热相关产品与半导体设备精密零部件行业均具备较高的技术壁垒与客户准入壁垒，产品研发与制造涉及热工学、精密机械、材料工艺等多学科交叉应用，对加工精度、运行可靠性、定制化适配能力要求严苛。

AI 服务器液冷散热细分领域，虽然尚处于技术导入初期，但已同步进入快速迭代通道，核心零部件（尤其以柜内的散热部件为代表）不仅需高度适配机柜

整体散热架构，更需满足流道微米级粗糙度控制、长期密封耐压、导热性能优良等严苛性能要求；液冷服务器自动化组装与检测设备需深度匹配客户定制化产线需求，具备较高的技术门槛与产品附加值。半导体设备精密零部件细分领域，现处于国产化替代加速阶段，高端精密结构件、治具等产品对加工精度、产品洁净度、质量长期可靠稳定性等方面的要求极高。两大领域下游客户认证周期长、准入标准严格，叠加行业技术迭代速度快，均对供应商的快速响应与工艺优化能力提出了较高要求，较强的定制化研发设计与深厚的精密制造技术积淀是企业构筑竞争优势的核心基础。

公司依托于在精密制造领域的深厚技术积累，凭借与核心客户稳定、深入的合作关系，于 2026 年初开始切入 AI 服务器液冷散热部件细分赛道。随着北美终端客户最新架构 AI 服务器机柜出货量提升，公司液冷部件订单量预计将快速增长，亟需通过扩产来满足客户订单交付需求。同时，全球 AI 服务器出货量提升同步带动服务器自动化组装、检测设备需求增长，公司不仅持续服务国内头部服务器厂商客户，自 2026 年起进一步切入北美终端客户供应链，相关订单规模快速扩大，现有产线已无法满足交付要求，亟需扩大对应产品的生产能力。在半导体设备精密零部件领域，公司已实现精密零部件等产品的批量供货，核心客户订单需求充足，公司同样需要加大产线投入和高精密加工技术人员招募来实现产能扩展，提升接单能力。

（二）本次募集资金投资项目实施的目的

1、突破产能瓶颈，全面承接市场增量需求

2026 年是公司业务结构升级的关键里程碑节点。本年度公司成功切入北美头部客户 AI 服务器供应链，供应 AI 服务器液冷散热部件、AI 服务器自动化组装线及检测设备等产品；2026 年度，公司散热部件收入占比有望成为公司第一大收入品类，打破自成立以来以“工具类”产品为核心收入来源的业务格局；AI 服务器及网络通讯细分领域预计将成为第一大收入来源领域，扭转过往收入主要来源于移动智能终端细分领域的局面。

与治具、配套零部件、自动化设备等生产工具类业务相比，液冷服务器散热部件等“产品类”业务具备订单延续性更强、需求规模更大的特征，只要终端 AI

服务器保持持续出货，对应散热部件的需求就具备长期稳定性。与此同时，国内半导体设备产业正处于国产化替代加速推进的关键阶段，各类半导体设备需求快速增长，直接拉动公司半导体设备精密零部件产品的市场需求。

目前公司已实现出货的 AI 服务器液冷散热部件以机柜内中央分水器（inner manifold）、波纹管模组为主，以及公司子公司东莞市铝宝金属科技有限公司的服务器机柜 stiffener 精密结构件（不属于本次募投项目扩产范畴）等。整体来看，不管是 AI 服务器液冷散热部件，还是 AI 服务器生产过程中所需使用的自动化组装线、自动化检测设备等，亦或是半导体设备精密零部件产品，均处于国内外需求快速增长、市场空间广阔的发展阶段。公司现有的设备产能、技术人员储备、生产场地空间等都已无法匹配客户订单的快速增长。因此，对于前述三类产品的产线进行必要的扩大，是公司本次定向发行股票进行融资的最直接目的。

本次发行拟投资建设强瑞技术龙华区总部基地，并配套实施 AI 服务器精密液冷散热部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目和高端半导体设备精密零部件生产制造项目，系统性扩充两大业务规模化产能，有效突破产能制约，精准匹配下游 AI 算力建设与半导体设备国产化的增量需求，深度把握行业高速增长机遇。

2、优化业务结构与产业布局，强化多赛道协同竞争优势

公司上市初期聚焦移动智能终端领域，近年来依托精密制造核心能力，逐步向 AI 服务器、半导体、智能汽车、机器人等领域延伸，持续推进业务结构优化升级。本次募投将 AI 服务器相关业务作为重点拓展方向，扩充高附加值液冷散热部件、自动化组装及检测设备产能，打造公司未来核心增长引擎；同时深化半导体设备精密零部件业务布局，进一步丰富高端精密制造产品矩阵，为公司未来业绩增长的奠定坚实基础。

两大业务均以精密制造为核心底座，与公司原有业务领域形成较强的协同效应：技术层面，共享定制化研发设计、高精度金属加工工艺、焊接工艺和自动化设备装配工艺等，提升研发、生产效率、降低成本；客户层面，依托头部客户资源实现跨场景业务拓展，深化合作粘性与服务深度；供应链层面，统筹核心原材料与外协加工服务的采购资源，增强议价能力与供应链稳定性。在不脱离核心工

艺能力的基础上，进一步丰富公司业务布局，能够有效提升公司的抗风险能力，提升盈利能力，强化公司在高端精密制造领域的综合竞争优势。

3、优化资本结构，提升持续经营能力与抗风险能力

本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有助于缓解公司业务规模扩张带来的营运资金压力，降低财务成本，优化资本结构与资产质量。同时，充足的资金储备可为公司持续的技术研发、市场拓展、新客户认证与产能爬坡提供有力保障，支撑 AI 服务器液冷散热相关产品及半导体设备精密零部件赛道战略布局稳步落地，增强公司抵御市场波动、应对行业周期的能力，推动长期可持续发展。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目

1、项目概述

本次 AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目由公司全资子公司强瑞装备实施，通过租赁公司建设的龙华区总部基地场地开展生产运营，项目计划总投资为 51,290.91 万元，拟使用本次募集资金 43,000.00 万元。

本项目募集资金主要用于购置高端精密加工、焊接、自动化组装及性能检测等设备，系统性扩大公司 AI 服务器液冷散热相关产品的产能规模。项目聚焦 AI 服务器液冷散热核心零部件、自动化组装及检测设备的研发与规模化制造，核心产品涵盖中央分水器（inner manifold）、波纹管模组等液冷散热部件，液冷服务器自动化组装线及液冷服务器检测设备等。鉴于公司 AI 服务器相关业务当前订单增长迅速，产能扩建需求较为急迫，项目前期将采用租赁外部厂房的方式先行投产，强瑞技术龙华区总部基地建成后整体搬迁入驻。项目全面达产后，将显著提升公司 AI 服务器液冷散热相关产品的供货能力与技术迭代实力，匹配下游 AI 算力产业的高速增长需求。

2、项目建设的必要性

(1) 政策与产业趋势共振，把握 AI 服务器行业快速发展战略机遇

以 AI 服务器为核心的算力基础设施是数字经济的核心底座，液冷技术是支撑高密度 AI 算力集群稳定运行、落实数据中心绿色低碳要求的核心方案，当前以北美地区为代表的海外市场作为全球 AI 产业的主要阵地，当地政府持续出台人工智能顶层规划，头部科技巨头持续增加资本开支，加速布局通用大模型研发、大规模超算算力集群建设，算力集群功率密度快速抬升。

从市场空间来看，AI 大模型训练与推理需求爆发式增长，推动服务器单机柜功率密度持续抬升，传统风冷逐步触及性能瓶颈，液冷正由试点应用加速转向规模化普及。根据 Precedence Research 数据，2025 年全球 AI 服务器市场规模已达 392 亿美元，预计 2034 年将增长至 3,523 亿美元。本项目旨在通过扩充 AI 服务器液冷散热相关产品的产能，助力公司深度参与算力基础设施升级进程，是公司把握政策红利与 AI 服务器行业高速增长机遇的必要布局。

(2) 实现精密制造主业延伸，推动营收结构向高附加值方向优化升级

本项目立足公司深耕多年的精密制造领域，依托定制化研发设计、高精度复杂零部件加工、全流程质量管控等成熟技术优势，向 AI 服务器的液冷散热相关领域延伸升级，属于公司主业的自然拓展，不存在跨界经营风险。

技术端，公司深耕金属精密加工行业十余年，在材料工艺、精密加工、精密焊接、组装检测、全流程质量管控等环节积累了深厚的产业化经验。2026 年以来，公司依托成熟的精密治具、结构件加工能力切入 AI 服务器液冷散热部件领域，属于公司精密金属加工能力适用对象的丰富，本质是精密制造能力的应用场景拓展。

客户端，公司已向国内头部服务器厂商交付液冷服务器检测设备多年，技术实力与产品品质获得充分验证；2026 年公司进一步将业务拓展至北美头部服务器客户供应链，向其间接供应服务器自动化组装线及检测设备等，属于客户群体的丰富延伸，业务拓展具备扎实的客户基础。

通过实施本项目，公司将进一步丰富产品应用领域，深度参与 AI 服务器市场，从根本上改变过往对于移动智能终端市场较大程度的依赖，切实降低经营风险，提升股东回报水平。现阶段 AI 服务器赛道处于高速发展期，相关产品附加值显著高于传统业务，本项目是在现有技术、客户与供应链体系上的产能扩容与工艺升级。项目达产后，将持续提升高附加值业务在公司营收中的占比，优化产品矩阵与收入结构，提升公司整体盈利水平与抗周期能力。

（3）突破产能瓶颈，匹配客户订单增长与市场扩容需求

当前公司 AI 服务器液冷散热相关产线已处于满负荷运转状态，核心加工设备产能紧张，且现有生产车间空间受限，无法通过新增设备进一步扩充产能，已难以充分匹配客户快速增长的订单交付需求，产能瓶颈已成为制约 AI 服务器液冷散热相关业务规模扩张的核心因素。

本项目依托强瑞技术龙华区总部基地实施，核心用于购置高端精密加工、精密焊接、自动化组装及液冷专用性能检测等高精密设备，配套建设定制化生产场地，可有效突破现有设备的工艺精度瓶颈与场地空间限制。项目投产后，公司 AI 服务器液冷散热相关产品的制造组装能力将实现质效与规模的双重跃升：一方面可充分承接现有核心客户的增量订单，保障交付效率与产品品质一致性；另一方面也为后续新客户拓展、市场份额提升提供坚实的产能支撑，同时通过规模化生产优化成本结构，实现业务规模与盈利能力的同步增长。

3、项目可行性分析

（1）核心工艺积淀深厚，技术适配性经过客户验证

公司深耕精密制造领域多年，核心技术围绕定制化研发设计、精密加工、复杂结构件成型、设备组装等关键环节，经过长期产业化验证，技术成熟度与稳定性兼具，与 AI 服务器液冷散热相关产品的技术要求高度适配。针对 AI 服务器液冷散热部件的加工与检测需求，公司已形成成熟的量产工艺方案，核心生产工艺与产品性能通过多家头部客户的专项验证，完全具备技术落地基础；AI 服务器自动化组装线方面，公司现阶段已交付的 3 条线体均获得客户高度认可；液冷检

测设备方面，公司已向国内头部服务器厂商稳定交付多年，技术实力能够满足甚至超越客户需求。

本次募投是基于现有核心技术的优化与产能释放，聚焦 AI 服务器液冷散热相关产品的规模化生产与工艺升级。针对液冷散热相关产品的精密复杂加工、精密焊接密封、多参数同步检测等技术需求，公司已完成关键工艺的适配测试，可直接复用现有技术团队与研发资源，无需进行颠覆性技术攻关。同时，公司建立了常态化技术迭代机制，具备成熟的定制化研发能力，能够快速响应客户产品迭代与定制化需求，为项目投产后的技术稳定性、产品竞争力提供坚实保障。

（2）客户资源优质稳固，产能消化具备多重保障

公司依托长期积累的优质客户资源实现 AI 服务器液冷散热相关业务的无缝拓展，客户合作粘性强、订单增长确定性高，为项目新增产能的消化提供了坚实支撑。

AI 服务器液冷散热部件领域，公司核心产品包括中央分水器(inner manifold)、波纹管模组等，目前已通过多家头部客户验证，并实现对部分客户的批量交付。随着终端客户最新架构 AI 服务器机柜的批量出货，公司液冷散热部件订单量预计将保持快速增长；部分核心客户基于自身所获取的订单情况等，已明确对公司的后续增量采购意向，为募投项目投产初期的产能消化提供核心保障。AI 服务器自动化组装线及液冷检测设备领域，公司与核心客户的合作持续深化，新项目推进顺利，终端客户群体不断扩容，订单具备较强的延续性。

同时，公司可依托现有优质客户资源实现跨品类业务拓展，进一步夯实产能消化基础。

（3）量产运营体系成熟，项目落地具备充分保障

公司在精密制造领域拥有多年生产运营经验，已形成成熟的标准化量产管理与柔性交付相结合的生产模式，配套完善的全流程质量管控体系，可充分适配各类订单的生产交付需求。目前公司 AI 服务器液冷散热相关产品的生产工艺已趋于成熟，生产流程与质量标准逐步固化，具备规模化量产基础。

不管是针对 AI 服务器液冷散热部件还是 AI 服务器自动化组装线及液冷检测设备，本项目的实施均可直接复用公司成熟运营资源：生产端，沿用现有的生产管理流程，搭建专属量产链路，保障批量交付的效率与品质一致性，同时保留柔性调配能力，可快速响应客户的差异化适配需求；质量端，复制全流程质量管控体系，并针对液冷散热部件密封性、洁净度等增设专项检测环节，从原材料入库检验、生产过程巡检、成品精密检测到出库复核实现全链条可追溯；人才端，由公司调配核心生产、技术与管理团队负责项目运营，快速组建补充一线执行团队，无需从零搭建运营体系。供应链端，公司已构建覆盖多品类金属材料、精密铸件、外协加工服务等领域的合格供应商网络，建立供应商动态评价与应急储备机制，同时针对液冷散热部件专用原材料储备多家备选供应商，可有效应对供应链波动风险。

此外，项目后续入驻强瑞技术龙华区总部基地，周边精密加工、设备运维等上下游产业集群成熟，产业配套完善，可快速获取配套服务，降低项目建设与运营成本，进一步提升项目实施的可行性。

4、项目实施主体、实施地点

本次 AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目由公司全资子公司强瑞装备实施，通过租赁公司建设的龙华区总部基地场地开展生产运营，其地址为深圳市龙华区库坑同富裕工业区 28 号华朗嘉工业园（以公司最终取得该地块的不动产权证书记载地址为准）。

截至本报告出具日，强瑞技术龙华区总部基地建设项目已被遴选为龙华区重点产业项目并明确了初步用地方案，公司将按照相关法律法规履行相关用地取得程序。由于公司产能扩建较为急迫，项目前期将租赁外部厂房实施项目，待新厂房建成后搬迁。

5、项目涉及的有关报批事项

截至本公告出具日，本项目涉及的报批事项尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

6、项目投资估算及预计经济效益

本项目总投资 51,290.91 万元，项目的实施将提升公司的生产能力与技术水平，并通过新增产能满足不断扩大的市场需求，从而进一步发挥规模经济效应，增强公司的盈利能力。

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

（二）高端半导体设备精密零部件生产制造项目

1、项目概述

本次高端半导体设备精密零部件生产制造项目由公司全资子公司深圳强鹏芯实施，通过租赁公司建设的龙华区总部基地场地开展生产运营，项目计划总投资为 13,792.68 万元，拟使用本次募集资金 11,500.00 万元。

项目募集资金主要用于购置五轴数控加工中心、高精度检测设备等精密加工与量测装备，系统性扩充半导体设备精密零部件等产品的产能。项目建成后，将有效提升公司半导体设备精密零部件等产品的整体供货能力与研发迭代效率，为持续扩大市场份额奠定坚实基础。

2、项目建设的必要性

（1）政策与行业机遇叠加，契合国产化替代战略

半导体产业是国家战略性基础产业，关键设备及核心零部件国产化是保障产业链安全、培育新质生产力的核心方向。本次募投项目聚焦半导体设备精密零部件等产品的产能扩充与技术升级，属于《战略性新兴产业分类（2018）》中“新一代信息技术产业”下的“新型电子元器件及设备制造”范畴，同时属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“集成电路装备及关键零部件制造”类别，属于明确的鼓励类产业方向，契合国家产业政策导向。

从市场规模来看，行业增长动能强劲。根据 SEMI 数据，2025 年中国半导体设备市场规模达 540 亿美元，2020-2025 年年均复合增长率约 23.63%，预计 2027 年中国半导体设备市场规模将增长至 662 亿美元。弗若斯特沙利文预计，

随着中国半导体行业的持续发展，以及半导体设备零部件市场供应链安全性与稳定性的不断提升，市场规模将持续稳步发展，中国半导体设备零部件市场规模预计将从 2025 年的 1,929.9 亿元增长至 2029 年的 2,735.3 亿元，期间的年均复合增长率预计将达约 9.1%。本项目通过扩大产能，助力公司深度参与半导体设备产业链自主化进程，是把握政策红利与行业增长机遇的必要布局。

（2）深化主业布局，支撑业务规模持续扩张

本项目立足公司精密制造核心能力，是半导体设备精密零部件等产品的产能扩充与深化布局，属于主业能力的自然延伸。半导体设备精密零部件业务已成为公司收入的重要增长极，公司现已成功切入国内多家知名半导体设备企业供应链，具备持续盈利的业务基础。近年来下游需求快速增长，公司现有半导体设备零部件等产品的产能已趋于饱和，亟需通过本次募投项目进一步扩充产能规模，满足客户较快增长的订单需求，支撑业务持续增长。

本次募投项目将进一步扩大半导体设备精密零部件等产品的整体供给规模，优化快速响应的业务服务模式，强化公司在该细分市场的综合竞争力。同时，项目将有助于持续优化公司整体业务结构，降低对单一领域较大程度依赖的风险，提升综合抗风险能力与长期盈利水平。

（3）缓解产能瓶颈，充分承接市场增量需求

伴随半导体设备精密零部件相关业务订单持续快速增长，公司现有的位于东莞的半导体设备精密零部件生产基地的产能难以匹配下游需求的增长速度，核心生产设备持续高负荷运行，精密加工技术人员缺口较大，部分工序仍需通过外协辅助加工，既推高了生产成本，也影响了交付响应效率，产能瓶颈已成为制约公司半导体设备零部件相关业务规模扩张的核心因素。

本次项目依托强瑞技术龙华区总部基地建设项目实施，核心配置五轴数控加工中心、高精度检测设备等生产加工设备，此类设备具备微米级加工精度、高稳定性制程管控、复杂结构一体化加工等特性，可有效扩充公司精密加工环节的产能规模。项目投产后，公司半导体设备精密零部件等产品的制造能力与供货效率

将实现显著提升，充分匹配半导体设备产业的市场增长需求，全力承接头部客户的扩产订单，为进一步提升市场份额提供坚实产能支撑；通过核心工序自主化生产优化整体成本结构，进一步巩固产品品质稳定性，实现半导体业务规模与盈利能力的同步增长。

3、项目可行性分析

（1）技术能力扎实，核心优势突出且适配性强

公司深耕精密加工领域多年，核心技术均围绕精密制造、定制化研发设计、复杂零部件加工等关键环节，且经过长期产业化验证，技术成熟度与稳定性兼具。针对半导体设备精密零部件等产品对微米级精度、高可靠性的严苛要求，公司已形成专属工艺方案，核心生产工艺通过知名客户的验证，契合半导体设备行业对供应商的技术标准。

本次项目并非全新技术领域拓展，而是基于现有核心技术的产能扩张，核心聚焦半导体设备精密零部件等产品的规模化生产及工艺优化。针对半导体设备相关零部件产品的复杂结构、特殊材质加工等需求，公司已完成关键工艺的适配测试，可直接复用现有技术团队与研发资源，无需进行颠覆性技术攻关。同时，公司建立了常态化技术迭代机制，能够快速响应客户定制化需求与行业技术升级趋势，为项目投产后的技术稳定性、产品竞争力提供坚实保障。

（2）客户合作粘性较强，市场拓展有序推进

半导体设备行业对供应商准入门槛高、认证周期长，合作粘性强。公司凭借过硬的技术实力与交付能力，已与多家国内知名半导体设备企业建立稳定合作关系，产品覆盖精密结构件、核心零部件等，客户合作深度与稳定性持续提升。

从产能消化保障来看，公司现有半导体业务在手订单充足，核心客户基于自身所获取订单情况，对精密零部件等产品的增量需求明确，将为项目新增产能消化提供核心支撑；同时，公司可依托现有客户资源深化合作层级，丰富供应产品品类，提升单客户价值，为项目达产后产能全面释放构建长效保障，新增产能的市场消化具备扎实基础。

(3) 运营模式成熟可复制，项目实施风险可控

公司半导体设备精密零部件等业务已在东莞基地实现规模化落地，相关业务收入较快增长，充分验证了适配半导体行业特性的生产管控模式与质量体系的可行性。针对该业务的生产交付，公司已构建专属制程管控体系：生产端可根据产品的精度等级、材质特性与结构复杂度匹配定制化工序路线，保障高精度加工、特殊表面处理等关键环节的制程稳定性，适配半导体设备零部件产品多品类、高要求的交付特点；质量端建立符合半导体行业标准的全链路追溯机制，覆盖原材料入厂定级、关键工序巡检、成品尺寸与性能全项检测等全流程，确保产品精度、洁净度与长期运行可靠性满足客户严苛标准。团队方面，公司已组建稳定的半导体业务专属生产与技术团队，可快速完成新的产线搭建与人员配置，项目落地无需从零搭建运营体系。

4、项目实施主体、实施地点

本次高端半导体设备精密零部件生产制造项目由公司全资子公司深圳强鹏芯实施，通过租赁公司建设的龙华区总部基地场地开展生产运营，其地址为深圳市龙华区库坑同富裕工业区 28 号华朗嘉工业园（以公司最终取得该地块的不动产权证书记载地址为准）。

截至本报告出具日，强瑞技术龙华区总部基地建设项目已被遴选为龙华区重点产业项目并明确了初步用地方案，公司将按照相关法律法规履行相关用地取得程序。

5、项目涉及的立项、环保等有关报批事项

截至本报告出具日，本项目涉及的报批事项尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

6、项目投资估算及预计经济效益

高端半导体设备精密零部件生产制造项目总投资 13,792.68 万元，项目的实施将提升公司半导体精密零部件的生产能力与技术水平，并通过新增产能满足不断扩大的市场需求，从而进一步发挥规模经济效应，增强公司的盈利能力。

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

（三）强瑞技术龙华区总部基地建设项目

1、项目概述

本项目由强瑞技术作为实施主体，计划在深圳市龙华区建设高标准智能制造生产及总部基地。项目计划总投资为 30,649.33 万元，拟使用本次募集资金 22,000.00 万元。项目主要建设内容包括生产厂房、办公及研发场所、其他综合配套建筑等，建成后一方面作为公司 AI 服务器液冷散热相关业务、半导体设备精密零部件业务的核心生产承载平台，通过租赁方式提供给全资子公司强瑞装备和深圳强鹏芯，用于 AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目和高端半导体设备精密零部件生产制造项目的生产运营；另一方面将作为公司总部办公场地，替代公司现有分散租赁的办公场所，优化集团整体办公与管理布局。

本项目的实施将统筹解决公司 AI 服务器液冷散热相关业务、半导体设备精密零部件业务的长期产能载体需求，同时改善总部办公及研发配套条件，优化集团整体产能布局与运营管理效率。

2、项目建设的必要性

（1）满足核心业务长期扩产的载体需求，突破场地资源瓶颈

伴随公司 AI 服务器液冷散热相关业务、半导体设备精密零部件业务订单快速增长，现有分散租赁的生产场地已接近饱和，且存在场地布局零散、配套能力不足、扩产弹性有限等问题，难以匹配业务长期规模化发展的需求。同时，公司当前总部及各职能部门均采用租赁方式办公，场地分散且租赁到期存在不确定性，不利于集团统一管理与长期稳定经营。本项目通过自建标准化生产基地及总部办公研发场所，可一次性解决两大核心业务的生产场地缺口与公司总部办公场地需求，为后续产能持续扩张、研发效率提升、经营管理优化提供稳定载体，避免频繁搬迁、分散租赁带来的运营损耗与管理成本。

（2）统筹公共资源配置，提升集团整体运营效率

本项目建成后将统一配置环保设施、仓储物流等公共配套资源，避免子公司各自租赁场地的重复投入；同时可实现研发、生产、供应链的集中管理与协同联动，缩短产品研发与量产转化周期，提升整体运营效率与成本管控能力，强化公司精密制造的体系化优势。

（3）定制化适配生产工艺要求，提升品质管控水平与交付保障能力

精密制造业务对厂房空间布局、设备承重、动力供给、环境洁净度等均有较高的定制化标准，现有租赁场地受原有建筑条件制约，难以完全适配高精度精密加工、AI 服务器液冷散热相关产品密封性能测试、半导体设备精密零部件制程管控等特殊生产场景的要求。本项目可结合 AI 服务器液冷散热相关业务、半导体设备精密零部件业务的工艺特性进行定制化厂房规划与配套建设，优化生产动线布局，适配高端生产设备的安装运行与制程管控标准，进一步提升生产效率与产品品质一致性；同时自有产权厂房可彻底规避租赁协议到期、租金波动、场地调整等不确定性风险，保障产能供给的长期稳定性，夯实对下游核心客户的交付保障能力。

3、项目可行性分析

（1）产业规划与土地政策支持，项目建设具备政策基础

本项目属于高端精密制造范畴，契合深圳市及龙华区产业发展导向，符合区域工业用地规划与智能制造产业扶持政策。本项目已被遴选为龙华区重点产业项目并明确了初步用地方案，公司将按照相关法律法规履行相关用地取得程序。

（2）两大业务增长明确，场地需求具备坚实支撑

公司 AI 服务器液冷散热相关业务已进入批量交付阶段，半导体设备精密零部件业务订单持续快速增长，两大业务产能扩张规划清晰，对稳定、规模化的生产场地需求明确且迫切。本项目的建设规模与功能布局均基于两大业务的中长期发展规划及公司总部运营需求设计，产能载体与办公场地的消化具备扎实的业务基础，不存在场地闲置的风险。

（3）内外资源协同推进，项目落地具备充分保障

公司深耕精密制造领域多年，具备成熟的产线规划搭建、设备调试投产与全流程生产管控能力，能够高效完成设备进场、产线调试与产能爬坡等核心环节。针对厂房工程建设环节，公司将选聘具备相应资质与丰富工业厂房建设经验的专业机构承担设计与施工工作，并组建内部专项项目组统筹进度管控、质量监督与投产衔接，通过外部专业基建能力与内部成熟运营经验的协同配合，保障项目按计划顺利推进。同时项目建成后采用集团内部租赁的运营模式，相关生产管理、质量管控体系可直接复用现有成熟机制，运营层面不存在实施障碍。

4、项目实施主体、实施地点

本项目由强瑞技术实施，实施地点为深圳市龙华区库坑同富裕工业区 28 号华朗嘉工业园（以公司最终取得该地块的不动产权证书记载地址为准）。截至本报告出具日，本项目已被遴选为龙华区重点产业项目并明确了初步用地方案，公司将按照相关法律法规履行相关用地取得程序。

5、项目涉及的有关报批事项

截至本报告出具日，本项目涉及的报批事项尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

6、项目投资估算及预计经济效益

强瑞技术龙华区总部基地建设项目作为基地建设，不会产生直接的经济效益。项目建设完成后，将主要作为公司 AI 服务器液冷散热相关业务和半导体设备精密零部件业务的核心承载平台，通过租赁方式提供给全资子公司强瑞装备和深圳强鹏芯用于 AI 服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目和高端半导体设备精密零部件生产制造项目的生产运营。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 28,500.00 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

随着公司业务的发展，公司产品结构不断丰富、业务规模稳步增长，对流动资金的需求将日益增加。本次募集资金部分用于补充流动资金有助于缓解公司日常经营的资金压力，优化公司的财务结构，提高抗风险能力，为未来公司业务规模扩张提供保障，为公司可持续发展打下良好的基础。

3、项目实施的可行性

公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。结合监管要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，严格规范募集资金的存储及使用。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金违规使用风险。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司主营业务为精密治具、设备、散热部件、电机及零部件等产品的研发、生产与销售，为客户智能制造提供配套支持，核心围绕定制化研发设计和精密加工能力展开，产品已覆盖移动 AI 服务器及网络通讯、移动智能终端、机器人、智能汽车、半导体等领域。本次募集资金投资项目结合了公司现状、市场需求及未来行业发展趋势，与公司现有主业紧密相关且系核心能力的自然延伸。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次募集资金投资项目建成后，将扩大公司的生产能力，提升公司的生产运营效率和研发能力，发挥公司规模生产效应，进一步提高公司核心竞争力，有利于公司维护及拓展公司客户资源，巩固公司行业地位，对公司长期可持续发展及维护股东长远利益具有重要意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额均将有一定幅度的提高，公司资金实力将有所增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。本次发行将使公司的资本结构更加稳健，有利于降低财务风险，提升偿债能力和

抗风险能力。

本次募投项目建设需要一定的实施周期，短期内部分募投项目经济效益不能完全释放，对公司每股收益和净资产收益率等指标产生一定影响，但随着募投项目建设完毕并产生收益，公司盈利能力将得到进一步提升，有利于公司长远发展。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上，经审慎分析论证，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展需要，符合行业发展趋势，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，增强盈利能力，提高公司核心竞争力。公司资本结构将得到进一步优化，资金实力进一步提升。本次发行募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

（本页无正文，为《深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页）

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日